



Hewlett Packard
Enterprise

Digital data sheet

HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module

Synergy Compute



技術規格

HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module

處理器數量備註	2 或 4
處理器速度	3.6 GHz
擴充插槽	(6 個) 如需詳細說明，請參考規格速覽
最大記憶體	6 TB
記憶體插槽	48 個 DIMM 插槽；最多
記憶體類型	DDR4 SmartMemory
記憶體防護功能	進階 ECC；記憶體鏡像模式；記憶體線上備用模式
系統風扇功能	針對運算模組
保固	3/3/3 伺服器保固包括三年零件、三年人工、三年到府支援服務。如需有關全球有限保固和技術支援的詳細資訊，請造訪： www.hpe.com/services/support 。您可以在當地購買適用於您產品的其他 Hewlett Packard Enterprise 支援和服務。如需是否提供服務升級以及這些服務升級成本的相關資訊，請參閱 www.hpe.com/services/support 。
基礎架構管理	HPE Synergy Composer 由 OneView (iLO) 提供技術支援
處理器	Intel
機型 (完整架構)	10U

其他資源

規格速覽

hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=a00008522enw

請來電洽詢是否提供：

www8.hp.com/us/en/hpe/contact/sales.html



訂閱最新消息

**Hewlett Packard
Enterprise**

版權所有 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP。本文件中包含的資訊如有變更，恕不另行通知。慧與產品與服務的唯一保固已明確記載於該類產品與服務隨附的保固聲明中。不應將本文件任何資訊視為構成額外的保固。慧與對於本文件的技術或編輯錯誤或遺漏概不負責。

Intel 為 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的商標。； Xeon 為 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的商標。

產品圖可能與實品有所出入。
PSN1010025844TWZH, August 05, 2017.